

DERWENT-ACC-NO: 1985-149523

DERWENT-WEEK: 198525

COPYRIGHT 2004 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Paste for thick film prodn. - produced by
adding small amt. of filler to dispersion of glass frit and
noble metal powder in organic vehicle

PATENT-ASSIGNEE: ROHM CO LTD[ROHL]

PRIORITY-DATA: 1983JP-0190135 (October 12, 1983)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE
PAGES MAIN-IPC		
JP 60081892 A	May 9, 1985	N/A
003 N/A		

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO
APPL-DATE		
JP 60081892A	N/A	1983JP-0190135
October 12, 1983		

INT-CL (IPC): C23C024/10, H05K003/12

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 60081892A

BASIC-ABSTRACT:

New paste for thick film prodn. is obt'd. by mixing 1-3 wt.% glass frit into 37-59 wt.% noble metal powder; dispersing the mixt. in 40-60 wt.% organic vehicle and adding 300-800 ppm filler.

USE/ADVANTAGE - The paste provides a thick film. No deformation is caused even when printing onto a section with different level, so that no cut in the coating film at that section occurs even if the film is made thinner compared with the previous ones, and even at the time of sintering. Degassing from the

: inside is ensured and swelling of the film, almost eliminated.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/1

TITLE-TERMS: PASTE THICK FILM PRODUCE PRODUCE ADD AMOUNT FILL
DISPERSE GLASS

FRIT NOBLE METAL POWDER ORGANIC VEHICLE

DERWENT-CLASS: L03 M13 U14 V04

CPI-CODES: L03-A01; L03-H04E4; M13-B;

EPI-CODES: U14-H02; V04-R02;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1985-065217

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1985-112672

⑫ 公開特許公報(A)

昭60-81892

⑪ Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和60年(1985)5月9日

H 05 K 3/12
C 23 C 24/107216-5F
7141-4K

審査請求 有 発明の数 1 (全3頁)

⑭ 発明の名称 厚膜用ペースト

⑯ 特 願 昭58-190135

⑰ 出 願 昭58(1983)10月12日

⑱ 発 明 者 明 智 方 俊 京都市右京区西院溝崎町21番地 ローム株式会社内
⑲ 出 願 人 ローム株式会社 京都市右京区西院溝崎町21番地
⑳ 代 理 人 弁理士 中沢 謹之助

明 細 書

1 発明の名称

厚膜用ペースト

2 特許請求の範囲

貴金属粉末 87～59 重量%に、ガラスフリット 1～8 重量%を混合し、これを有機ビークル 40～60 重量%に分散させ、かつこれにフィラー 800～800 ppm 添加してなる厚膜用ペースト。

3 発明の詳細な説明

この発明は厚膜用ペーストに関する。

周知のようにこの種ペーストは、貴金属の粉末にガラスフリットを混合し、これを有機ビークルに分散させて構成されている。従来の厚膜ペーストによる焼結後の膜厚は、一般には 15～25 μ、如何に薄くとも 8 μ 以下にならないように調整される。これは基板上に印刷されたペーストが流れ出してパターンの形がくずれないように、ペーストはチクソトロピック性になつてはいるものの、たとえば図に示すように基板 1 の表面にグレース層 2 を段状に形成してあるとき、グレース層 2 と

基板 1 との表面にまたがつて膜 3 を形成した場合、その段差部においては点線で示すようにペーストが流れやすくそのためこの部分の膜が薄くなつてしまい、ときには膜が途切れてしまうことがあるからである。

一方このように膜を厚くした場合、当然のことながら、貴金属の使用量が多くなり、製造価額は高くなるばかりでなく、焼成中に膜中又は膜下に発生或いは存在したガスが焼成中に抜けきれなくなり、そのため気泡となつて膜の一部を下方から或いは内部から押し上げてしまうことがある。これが膜の局部的なふくれを生ずる原因となる。このガス抜き困難性は、膜を充分薄くしても容易には改善されない。

この発明は薄い膜厚にしても段差部における形くずれを防止し、かつガス抜きを確実にする厚膜ペーストを提供することを目的とする。

この発明は、貴金属粉末 87～59 重量%にガラスフリット 1～8 重量%を混合し、これを有機ビークル 40～60 重量%に分散させ、更にこれ

にファイラー 300～800 ppm 添加した厚膜ペーストである。

この発明のひとつの重要な特徴は、前記の説明から理解されるように有機ビークルを従来例のものに比較して3～8倍程度に増した点であり、他のひとつの重要な特徴はファイラーを添加した点である。

有機ビークルは通常と同様にレジンと溶剤とからなる。レジンとしてはエチルセルローズが、溶剤としてはターピネオール、ブチルカルビトールアセテート等が使用される。有機ビークルはペーストのチクソトロビク性の向上に有効である。これを多量に混合することによつてペースト性を改善させ、段差部への印刷塗布に際しても膜切れの発生を防止する。又有機ビークルは焼結時に燃焼してしまうので、多量に混合しても特に問題は起らないし、のみならず多量に燃焼するので、その燃焼後の膜は、混合量が少い場合よりも極めて薄くなり、薄膜化に有効に作用する。更にこのように多量に有機ビークルを混合させれば、必然的

(3)

く形成することができた。従来のペーストによる場合が6～8μの厚みの金属膜とすることが必要であるところからすれば、半分以下の膜厚とすることができたと言える。そしてこのように膜を薄くしたことによつて、ファイラーによるガス抜き作用と相まつて、膜が厚い場合よりもガスが抜けやすくなり、したがって皮膜のふくれ、亀裂の防止を一層確実にする。

なお有機ビークルの混合量としては40～60重量％、特に45～49重量％程度が望ましい。60重量％をこえるとこれにともなつて貴金属の量が減少する。そのため導体抵抗が大きくなつてしまつて好ましくない。導体抵抗を所要の値にするには印刷回数を増して膜を厚くすればよいとしても、それだけ(厚膜の)製造工程が煩雑となる。又40重量％未満ではチクソトロビク性が不十分となり、段差部での形くずれを防ぐには不足である。

ガラスフリットは従来に比較して混合量は大差はなく、むしろやや少ない。これはファイラー中に

(5)

に貴金属の混合量は少くなる。このことは貴金属の使用量の低減化をうながすので、製造価格の低廉化に有効である。なおレジンと溶剤の重量割合は2:1乃至5:1が適当である。

使用するファイラーとしてはアルミナ(Al_2O_3)、酸化チタン(TiO_2)等のセラミックスが使用できる。粒径を0.1～0.85μとするこれらを混合しておく、と、ガス抜きが容易となる。これは焼結時ファイラーとペーストとの境界がガス抜き用の通路としての役目を果し、ガスはここを通つて表面に容易に抜けていくものと考えられる。これによつて残留ガスに基く膜のまくれ、亀裂等を確実に防止することができる。

この発明によるペーストによれば、チクソトロビク性が従来のもよりもすぐれており、従来のもものでは形くずれを起こした段差部においても、何ら形くずれを生じなかつた。そのため従来のようにペーストを厚く印刷する必要はなくなる。この発明によるペーストでは2.5～3μの厚みの金属膜を段差部において何ら形くずれを起すことな

(4)

も少量のガラス質が含まれており、これがガラスフリットとしての作用を果すものと考えられる。ここではたとえばホウケイ酸鉛ガラスが使用される。

貴金属粉末としては金が最も好ましく、この他銀、白金、バナジウム及びこれらの混合物でもよい。この発明では既述のように有機ビークルを多量に使用するので、これにともなつて貴金属の量は減少する。そして他の添加物の関係から87～99重量％となる。このように使用貴金属量が少くてすむことは、この種ペーストの製造価格が低廉となることを意味するので極めて都合がよい。

ファイラーはそれ自体が絶縁物である。そのためその添加量が800 ppmをこえると、エッチング時に邪魔な存在となつて高精度のエッチングが困難となる。又800 ppm未満ではこの発明の趣旨によるガス抜きのためには不十分である。

次にこの発明の一実施例による厚膜ペーストの組成と特性を示すと次表のようになる。なお従来例を比較のために併示した。

(6)

	従来例	本発明
金	85重量%	51重量%
鉛ガラス	3 "	2 "
有機ビークル (エチルセルロース) タービネオール	12 "	47 "
アルミナ	—	500ppm
焼結温度	850℃	850℃
シート抵抗	15 mΩ/□	22 mΩ/□
膜厚	8 μ	8 μ
印刷回数	2回	3回

なお前記シート抵抗は膜厚 3.0 μ における最大値を示す。

この発明によるペーストによつて得た金属厚膜は 180 cm の範囲内において皮膜のふくらみは零であつた。一方従来例のペーストによる場合は同じ面積範囲内において、皮膜のふくらみが 3~6 箇所発見された。又この発明によるペーストによるときは段差部（段差約 60 μ）においての形くずれが発生しなかつたことは言ひまでもない。

(7)

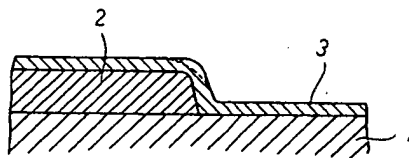
以上詳述したようにこの発明によれば、段差部への印刷においても形くずれは起らず、したがつて従来に比較して塗布膜が薄くとも段差部での膜の途切れは起らないし、又焼結時においても内部からのガス抜きは確実に行なわれ、皮膜のふくらみ等をほとんどなくすることができるという効果を奏する。

4. 図面の簡単な説明

図はペーストの塗布状態を示す断面図である。

1 基板、2 グレーズ層、3 膜

特許出願人 ローム株式会社
代理人 中沢謙之



(8)